

Title (en)  
Separation device

Title (de)  
Trennvorrichtung

Title (fr)  
Dispositif de séparation

Publication  
**EP 1357649 A1 20031029 (DE)**

Application  
**EP 03405217 A 20030401**

Priority  
• EP 03405217 A 20030401  
• EP 02405342 A 20020425

Abstract (en)  
Device for separating a current-carrying electrical conductor comprises housing, current connections, a conductor section, and propellant for producing compressed gas for separating the conductor section. The propellant is free from ignitable materials and the compressed gas amount required for the separation can be released from the propellant by the work of the residual current.

Abstract (de)  
Die Vorrichtung ist zum Auftrennen eines stromführenden elektrischen Leiters vorgesehen und weist ein Gehäuse (3) und zwei aus dem Gehäuse (3) geführte Stromanschlüsse (1, 2) auf. Im Gehäuseinneren (4) sind ein die beiden Stromanschlüsse (1, 2) miteinander verbindender Leiterabschnitt (7) und ein Treibmittel angeordnet. Das Treibmittel dient der Erzeugung von Druckgas in einer Menge, die ausreicht, um beim Auftreten eines Fehlerstroms den Leiterabschnitt (7) aufzutrennen. Das Treibmittel ist frei von zündbaren Stoffen gehalten und ist derart ausgewählt, dass die zur Auftrennung erforderliche Druckgasmenge durch die Stromarbeit des Fehlerstroms thermisch aus dem Treibmittel freisetzbar ist. Da in der Vorrichtung Explosivstoffe vermieden werden, kann die Vorrichtung völlig gefahrlos hergestellt, transportiert, installiert und gewartet werden. Nach der Inbetriebnahme zeichnet sich die Vorrichtung durch eine grosse Betriebssicherheit aus. <IMAGE>

IPC 1-7  
**H01T 1/14**; **H01T 1/12**

IPC 8 full level  
**H01T 1/10** (2006.01); **H01T 1/12** (2006.01); **H01T 1/14** (2006.01)

CPC (source: EP US)  
**H01T 1/12** (2013.01 - EP US); **H01T 1/14** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)  
• [A] DE 10047503 A1 20020418 - DISA TECH TECHNOLOGIE ENTWICKL [DE]  
• [DA] DE 10030669 A1 20020110 - SIEMENS AG [DE]  
• [DA] US 5434550 A 19950718 - PUTT ROBERT E [US]  
• [X] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 429 (E - 823) 25 September 1989 (1989-09-25)  
• [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 015, no. 405 (E - 1122) 16 October 1991 (1991-10-16)

Cited by  
DE102019207465A1; US9793701B2

Designated contracting state (EPC)  
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR

DOCDB simple family (publication)  
**US 2003210508 A1 20031113**; **US 7289309 B2 20071030**; AT E309635 T1 20051115; CN 100423391 C 20081001; CN 1453912 A 20031105; DE 50301587 D1 20051215; EP 1357649 A1 20031029; EP 1357649 B1 20051109; ES 2252645 T3 20060516; JP 2003332019 A 20031121; JP 4138564 B2 20080827; RU 2310958 C2 20071120

DOCDB simple family (application)  
**US 42293903 A 20030425**; AT 03405217 T 20030401; CN 03122424 A 20030425; DE 50301587 T 20030401; EP 03405217 A 20030401; ES 03405217 T 20030401; JP 2003113727 A 20030418; RU 2003112058 A 20030424